# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305915

(43)Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027

G03F 7/20

(21)Application number : 03-094867

(22)Date of filing:

02.04.1991

(71)Applicant: NIKON CORP

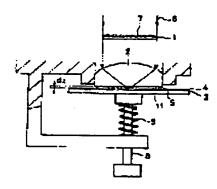
(72)Inventor: OZEKI HISAO

MATSUBARA TAKASHI

#### (54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

# (57)Abstract:

PURPOSE: To make thin the film thickness of an immersion liquid interposed between a photo-mask or an optical projection system and a wafer and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device. CONSTITUTION: A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on an exposure lens 2 through an immersion liquid 5. A surface-active agent 11 is mixed into the immersion liquid 5 within a range that the photoresist 4 is not affected, and the surface-active agent 11 reduces the surface tension of the immersion liquid 5, and improves wettability. Accordingly, the film thickness d2 of the immersion liquid is made thinner than the case where surface-active agent is not mixed.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出關公開各号

# 特開平4-305915

(43)公闆日 平成4年(1992)10月28日

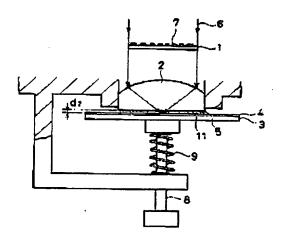
(51)Int.CL <sup>1</sup> H 0 1 L 21/66	識別配号	庁內蓋痙番号	F J	技術表示箇所	
G03F 7/20		7818—2H 7352—4M	H01L	21/30 3	11 A
***				審查胡求 未翻求 含	南水頂の数1(全 3 頁)
(21) 出額番号	特膜平3-94867		(71)出題人	000004112	
(22) 出題 日	平成3年(1991)4	月2日		株式会社ニコン 東京都千代田区丸の	カウスではっ張る色
	,		(72)発明者	大阳尚夫	7F101624637
					一丁目6番3号 株式
				会社ニコン大井製作	中所内
			(72) 発明者	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			1		一丁目6卷3号 碳式
			(T 4) 157W 4	会社ニコン大弁製作	
			(74)代理人	<b>分類土 山川 政</b> 議	ŧ

# (54) 【発明の名称】 密着型質光接置

#### (57) 【要約】

【目的】 お常型離光装置において、フォトマスクまた は投影光学系とウエハとの間に介在される没被の脱厚を 群くして光の吸収量を少なくし、露光ムラを経対防止す ることを目的とする。

【構成】 フォトレジスト4を整布されたウエハ3を露 光レンズ2に侵被5を介して啓着させる。複被5にはフォトレジスト4に影響を与えない範囲で界面活性剤11 が混入されており、界面插性剤11は、侵数5の表面張 力を減らし、微れ性を高める。したがって、侵彼の腹厚 dz は界面活性剤を退入しない場合より等くなる。



(2)

特第平4-305915

#### 【特許請求の範囲】

【餅求項1】 フォトレジストを墊布されたウエハを投 **影光学系もしくはフォトマスクに設徳を介して審着さ** せ、原射光の原射によりフォトマスクのパターンを前配 フォトレジストに転写するようにした密着国盤光設置に おいて、前配浸液は前記フォトレジストに影響を与えな い範囲で昇面選性剤が混入されていることを特徴とする 密等景象光绘图。

#### 【発明の為細な説明】

[0001]

【産業上の利用分界】本発明は、LSIの製造工程にお いて、フォトマスク上のパターンをウエハ上に投影露光 する解光装置、特に密着型偶光装置に関するものであ

#### [0002]

【従来の技術】レーザー光等を展別しフォトマスク上の パターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の半導 体基板上に投影器光するこの種の電光製設における開光 方式としては、①密着 (コンタクト) 健光方式、②プロ ンズ投影鷹光方式の4方式が知られている。

【0003】このうち密着腐光方式は、フォトマスク (または投影光学系) とウエハとを密着させて離光する もので、これらが完全に結若している場合には、フォト レジスト中の波長が風折率分の1に短くなるため、回折 の影響が少なく、高解像度の転写が得られるという特色 を有している。この密着は真空委者、静電チャック等に よって行っている。しかし、完全な密券を実現すること は極めて難しく、またフォトマスクとウエハとを機械的 トマスクに欠陥が至じ、その寿命を低下させると同時に デバイスの参留りに影響を及ぼすといった問題があっ

【0004】そこで、密治解光方式によるこのような問 題を解決する方法としてフォトマスクとウエハ閩に被体 (侵渡)を充填している。図2はウエハを浸液を介して 投影光学系に密着させた場合を示すもので、1はフォト マスク、2は投影光学系の一部を構成する弧光レンズ、 3はフォトレジスト4が塗布されたウエハ、5は露光レ ク1のパターン?を照射しフォトレジスト4を離光する 販貯光、8はウエハ3を保持する保持体、9は保持体8 を上方に付券しウエハ3を露光レンズ2に所定圧にて押 し付ける圧縮コイルばねである。 限射光6の被長は短い ほど回折の影響が少なく、そのため光頂としてエキシマ レーザー等のレーザー装置が用いられる。 没被5として は、屈折率がフォトレジスト4と同程度で光の吸収が少 なく、しかもフォトレジスト4を密かさないものが望ま しく、週常純水が使用される。

[0005]

【発明が無決しようとする課題】 しかしながら、上述し たような投液を使用した協名型電光装置においては、 侵破5自身の膜厚ムラがあると、浸蔵5による限制光6 の吸収量にムラが生じるため、コンタクト観光されたフ オトレジスト4のパターンが的確に膨光されている部分 とそうでない部分とが生じてしまうという問題があっ た。したがって、このような電光ムラの発生を防止する ため、役割5の構れ性を高めて表面張力を下げ、膜厚d 1 を振力薄くすることが望まれている。

10 【0006】本発明は上述したような従来の問題点およ び奥望に鑑みてなされたもので、その目的とするところ は、没致の旗序を葬くし、没抜による露光ムラを軽減防 止し得るようにした使着型露光装置を提供することにあ ₽.

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を造成 するため、フォトレジストを塗布されたウエハを投影光 学系もしくはフォトマスクに没液を介して密着させ、風 射光の限射によりフォトマスクのパターンを前記フォト キシミティ蘇光方式、③反射型投影蘇光方式、④縮小レ 20 レジストに転写するようにした徳若型露光粒優におい て、前記浸液は前記フォトレジストに影響を与えない義 囲で非面括性剤が混入されているものである。

#### [0008]

【作用】本発明において界面活性剤は浸液の溢れ性を高 め、疫症張力を下げる。したがって受伤の膜域を剪くす る.

### 100091

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて 詳細に説明する。図1は本発明に係る密着型電光変配の に接触させているためにウエハ表面の突起等によりフォージ 一実施例を示す要部の断面図である。なお、図中図2と 同一構成部品のものに対しては同一符号を以て示し、そ の説明を省略する。

> 【0010】本典施例は投影光学系にウエハを密着させ た場合を示すもので、フォトマスク投影光学系の一部を 傍成する電光レンズ2とウエハ3との間に介在される純 水等の浸液5に界面括性剤11を提入したものである。

【0011】界面活性剤11としては、脳イオン性、陰 イオン性、非イオン性等徴々のものが使用可能である が、風折率が浸液をと同程度で光の吸収が少なく、また ンズ2とウエハ3間に充填された投液、6はフォトマス 40 フォトレジスト4を指かしたりすることのない観閲で遊 入されることが留ましい。特に、隔イオン性のうち四級 アンモニウム塩系は、涸れ煙も高く、レジストへの影響 も少なく、光の吸収も少ないため好ましい。

> 【0012】かくしてこのような構成においては界面活 性刺11が浸液5の表面張力を被らして満れ性を高める ため、ウエハ3を所定圧力にて露光レンズ2に圧接した 際、没渡5の膜厚d』 を図2に示した従来被置と比較し て弊くする(dz くdi )ことができ、立た順早が降く なれば光の吸収量も少なくなるので、これに比例して光 50 の吸収ムラが減少し、電光ムラを軽減防止することがで

(3)

特朗平4-305915

きるものである.

[0013]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る格益型 庭光装置によれば、資務に界面活性剤を購入することに より、投紙自身の表面張力を試らして離れ性を向上させ るようにしたので、侵後の襲撃を導くすることができ る。したがって、授筱の膜厚ムラが小さく、光の仮収を 少なくすることができ、没欲による露光ムラを軽減防止 することができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る依着型露光数管の一実施例を示す 要都の断面図である。

【図2】密管型電光接触の従来例を示す更能の新面型で ある.

## 【符号の説明】

- 1 フォトマスク
- 2 露光レンズ
- 3 ウエハ
- フォトレジスト
- 投放 5
- 照射光
- 10 7 マスク
  - 11 界面器任利

